



Il portale del processo, del packaging e della logistica

PRODUTTORI DI  
TECNOLOGIE

TRASFORMATORI

INDUSTRIE E  
DISTRIBUZIONE

PACKAGING DESIGN

ENTI E ASSOCIAZIONI

EVENTI

VIDEO

## NEWS

**Mitsubishi Electric, l'automazione al servizio del packaging**

22 maggio 2019

**PLCnext Technology, i concetti innovativi di Phoenix Contact**

22 maggio 2019

**L'automazione firmata Beckhoff**

22 maggio 2019

**Lenze, il futuro della produzione è Plug & Produce**

22 maggio 2019

**Rockwell Automation, focus sulla Digital Transformation**

22 maggio 2019

**Turck Banner Italia presenta la funzione SIDI**

22 maggio 2019

**ProSweets Cologne 2020, già assegnato l'88% degli spazi**

20 maggio 2019

**Melinda ci mette la faccia**

20 maggio 2019

**Ottime prospettive per ProSweets Cologne 2020**

20 maggio 2019

**Bolognafiere Cosmoprof in Germania con la 9a edizione di Beauty Forum Leipzig**

17 maggio 2019

**Volpak, il confezionamento in pouch è sempre più green**

16 maggio 2019

**A Cosmoprof India 2019 focus sull'ottimizzazione delle opportunità di business**

16 maggio 2019

**Conto alla rovescia per Packaging Première 2019**

16 maggio 2019

**Italia, nuovo record nella raccolta degli imballaggi in acciaio**

16 maggio 2019

**Cresce l'industria italiana del packaging in cartone ondulato**

16 maggio 2019

## SPS Italia apre le porte alle tecnologie per la manifattura

Nel secondo Paese manifatturiero d'Europa, l'evoluzione 4.0 trova la sua fiera di riferimento in **SPS Italia**, dedicata all'industria intelligente, digitale e flessibile, a Parma dal 28 al 30 maggio 2019, dove saranno in mostra le migliori tecnologie per la manifattura in ambito automazione avanzata, meccatronica, digitale e software e robotica.

Anche quest'anno la manifestazione è in crescita (+5%) con oltre 850 espositori. Nei padiglioni 3, 5 e 6 ci sarà tutto il meglio delle tecnologie per l'automazione e soluzioni software al servizio della digitalizzazione della fabbrica.

### District 4.0

Nei padiglioni 4, 7 e 4.1 sarà allestito un percorso composto da quattro aree tematiche: Automazione Avanzata, Digital&Software, Robotica e Meccatronica, Competence Academy.

Le soluzioni esposte, partendo da una case history reale, riusciranno a illustrare le potenzialità di una tecnologia e non di un singolo prodotto, e allo stesso tempo sapranno evidenziare quali sono le competenze e le skill necessarie alle aziende per implementare le applicazioni più innovative.

### Robot&Co(bot)

Tra tutti i comparti legati a Industria 4.0 la robotica sembra essere quello che, negli anni, ha vissuto una crescita costante che ha portato le macchine in moltissime fabbriche, dalle più grandi alle piccole officine artigiane.

Uno dei principali highlight della nona edizione sarà il padiglione dimostrativo 4.1, dedicato alla robotica, alla meccatronica, ma anche a tutta la progettazione legata alla fase manifatturiera in cui robot hanno sempre più peso, con i più significativi player del comparto che presenteranno demo funzionanti e soluzioni meccatroniche articolate integrando componenti IT e OT.

### Incontri e formazione

Nel palinsesto spiccano per valore e interesse gli incontri per l'aggiornamento professionale e i convegni scientifici, organizzati in collaborazione con il Comitato Scientifico della manifestazione, con riconoscimento di crediti formativi (CFP). Il primo giorno si terrà il convegno inaugurale "Il futuro dell'industria? Qui e ora. Tecnologie e competenze per la manifattura italiana", la mattina del 28 maggio. In questa sede ANIE Automazione presenterà i dati di consuntivo del mercato italiano dell'automazione. Si discuterà poi dell'impatto sociale delle nuove tecnologie, un tema sul quale è importante informarsi per non cadere nelle trappole dei luoghi comuni. Saranno presenti



## LE RIVISTE

Rassegna **IMBALLAGGIO**

**BM** ITALIAN BUSINESS MANAGEMENT

**FM** FERTILIZER MANAGEMENT

## I PORTALI COLLEGATI

**PrintPUB.net**

## FOLLOW US



[More >](#)

## VIDEO



L'imballaggio flessibile secondo HP

## RIFLETTORI SU



## FOCUS TEMATICI

Sostenibilità

Packaging design

Private label

## ARCHIVI

Report eventi

Case history

Shanghai, 23-26 Oct 2019  
Technologies & packaging  
solutions for e-commerceLE TECNOLOGIE  
PER L'INDUSTRIA  
DEL FUTURO

i rappresentanti di tutti i Competence Center, che si presenteranno al mercato per la prima volta dalla loro costituzione. Infine si parlerà del futuro della comunicazione industriale, uno dei trending topics dei prossimi anni.

Inoltre, molte saranno le iniziative per una formazione attiva durante i tre giorni, a partire dal progetto in collaborazione con Fondazione Cariplo che vedrà il coinvolgimento di 76 Istituti Tecnici del "Progetto SI". Un'iniziativa per sostenere il miglioramento della qualità dell'istruzione tecnica nel territorio lombardo e nelle provincie di Novara e Verbano-Cusio-Ossola, attraverso l'aggiornamento delle dotazioni laboratoriali scolastiche. Non mancherà la formazione per i docenti. In collaborazione con AldAM, Didacta e ANIE Automazione, e patrocinato dal Miur, il progetto si propone di coniugare le finalità educative del sistema dell'istruzione e formazione professionale in raccordo con le esigenze del mondo produttivo del settore, nella prospettiva di una maggiore integrazione tra scuola e lavoro, con sessioni di formazione in fiera riservate al personale docente di istituti tecnici.

Enti e associazioni: **MESSE FRANKFURT** ITALIAEvento: **SPS/IPC/Drives** Italia

  
stampatori di etichette online






Post Press



Direct Mail &amp; Transpromo

